

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成24年10月4日(2012.10.4)

【公表番号】特表2012-505762(P2012-505762A)

【公表日】平成24年3月8日(2012.3.8)

【年通号数】公開・登録公報2012-010

【出願番号】特願2011-532105(P2011-532105)

【国際特許分類】

B 2 4 B 37/005 (2012.01)

B 2 4 B 37/00 (2012.01)

B 2 4 B 37/10 (2012.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 53/00 (2006.01)

B 2 4 B 53/12 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 37/00 X

B 2 4 B 37/00 A

B 2 4 B 37/04 G

H 0 1 L 21/304 6 2 2 M

H 0 1 L 21/304 6 2 1 D

B 2 4 B 53/00 J

B 2 4 B 53/12 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月17日(2012.8.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基底部の上側表面に連結されたプラテンを有する基底部と、
前記プラテンの上側表面に結合された研磨パッドであって、研磨面を有する研磨パッドと、

前記研磨パッドの周辺端に隣接して前記基底部に連結された支持部材と、
前記支持部材の上側表面に結合された受け材料であって、前記研磨パッドの前記研磨面と同一平面内にある上側表面を有する受け材料とを備えた装置。

【請求項 2】

前記プラテンが、円形であり、前記基底部に対して回転可能である、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

前記研磨パッドおよび前記受け材料がポリマー材料を含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

前記研磨パッドおよび前記受け材料が同じ材料を含む、請求項 3 に記載の装置。

【請求項 5】

前記支持部材が、前記研磨パッドの前記周辺端に対して横におよび / または垂直に前記支持部材を動かすための駆動システムに連結されている、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 6】

前記研磨パッドが可動であり、前記受け材料が、前記研磨面に対して固定されており、且つギャップによって前記研磨面から離間している、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 7】

基底部の上側表面に回転可能に連結されたプラテンを有する基底部と、
前記プラテンの上側表面に結合された研磨パッドであって、研磨面を有する研磨パッドと、
前記研磨パッドの周辺端に隣接して前記基底部に連結された支持部材であって、前記研磨パッドの前記研磨面に対して調節可能な支持部材と、
前記支持部材の上側表面に結合された受け材料と
を備えた装置。

【請求項 8】

前記研磨パッドが円形である、請求項 7 に記載の装置。

【請求項 9】

前記受け材料が犠牲材料である、請求項 7 に記載の装置。

【請求項 10】

前記研磨パッドおよび前記受け材料が同じ材料を含む、請求項 7 に記載の装置。

【請求項 11】

前記研磨パッドに対して X 方向および Z 方向に直線的に前記支持部材を動かすために前記支持部材に連結された駆動システム
をさらに備えた、請求項 7 に記載の装置。

【請求項 12】

前記駆動システムが空気モータを備える、請求項 11 に記載の装置。

【請求項 13】

前記受け材料が、前記研磨パッドに対して固定されており、且つギャップによって前記研磨パッドから離間している、請求項 7 に記載の装置。

【請求項 14】

円形の研磨パッドの周辺端をコンディショニングする方法であって、
回転する研磨パッドの研磨面に対してコンディショニングディスクを押し付けることと
、
前記コンディショニングディスクの少なくとも一部が前記研磨面の周辺端を越えて延びることを含むスイープパターンで、前記研磨面全体にわたり前記コンディショニングディスクを動かすことと、
前記スイープパターン全体にわたって前記コンディショニングディスクから前記研磨面への実質的に均一な圧力を維持することと
を含む方法。

【請求項 15】

前記スイープパターンが、前記研磨パッドから離れている受け面に接触するように前記研磨面の前記周辺端を横切って前記コンディショニングディスクの少なくとも一部をスイープさせることを含む、請求項 14 に記載の方法。